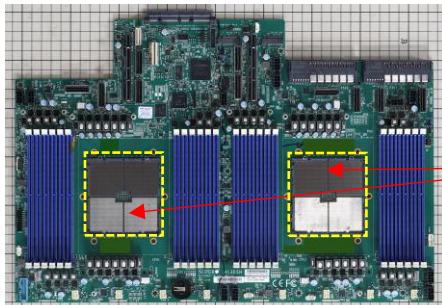
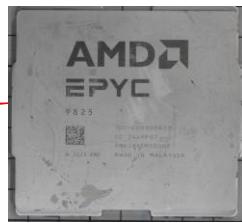


Server : AMD EPYC 9825搭載Supermicroサーバ 基板解析及びパッケージ解析レポート(Announcement)

Supermicro: 2U Hyper A+ Server (AS -2025HS-TNR)



メイン基板



パッケージ外観



パッケージ外観
(ヒートシンク除去後)

製品概要

AMD EPYC 9825は、チップレット構成を採用した128コアCPUで、12個のZen 4c CCDと1個のI/Oダイで構成されます。CCDは5nm、IODは6nmプロセスで製造され、Infinity Fabricで接続。高密度・高効率設計により、クラウドやHPC用途に最適です。Infinity Fabricとは、AMDが開発したチップ内部およびチップ間を接続するための高速インターフェクト技術で、複数のチップレットを統合して1つのプロセッサとして機能させる中核的な役割を担います。

今回、以下5つのレポートをリリース予定です。

1. 基板搭載半導体部品調査
2. 基板、パッケージの断面解析
3. 基板各層（14層）最細部のL/W測定
4. パッケージ各層(20層)画像データ
5. CCD,IODチップ解析（Top層、ゲート層、SEM断面（Seal Ring））

Note

CCD: Core Compute Die
IOD : I/O Die

次ページに詳細

解析内容 レポート価格

1. 基板搭載半導体部品調査 (650,000円) リリース予定 : 11/30

- 搭載半導体調査
- データシート (見つかった場合)
- ソケットなどの搭載部品拡大写真

2. 基板、パッケージの断面解析 (350,000円) リリース予定 : 11/30

- パッケージX線写真
- 断面構造
- 各層厚さ測定

3. 基板各層 (14層) 最細部のL/W測定 (650,000円) リリース予定 : 12/19

- 各層(14層)の最細部の線幅、線ピッチ測定

4. パッケージ各層(20層)画像データ (980,000円) リリース予定 : 11/30

- 各配線情報 (各層(20層)の写真、線幅、線ピッチ)
- オプションとしてCADデータ(ODB++ etc)の提供も可能です (追加250,000円)

5. CCD,IODチップ解析 (650,000円) リリース予定 : 2026/1/30

- Seal Ring部SEM 断面
- Top層、ゲート層写真
- オプションとして機能推定の提供も可能です (追加各チップ350,000円)